



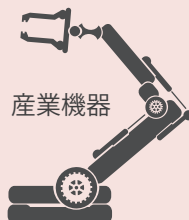
eSMP® シリーズ

小型・低背パッケージのダイオード／整流器向けソリューション

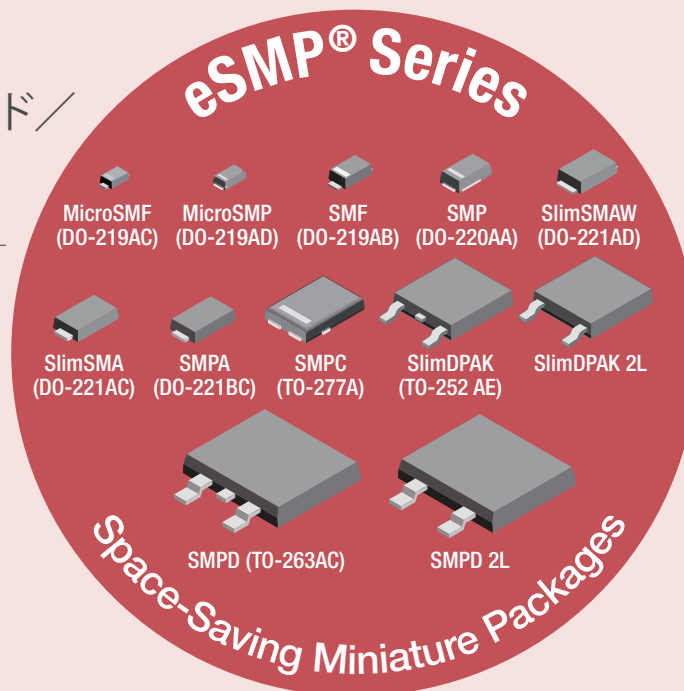
eSMP® パッケージ

小型・低背パッケージのダイオード／
整流器向けソリューション
高性能表面実装パワーパッケージ

用途



非対称／対称フラット型
パッケージで提供



高電流・高効率を実現
する独自設計で、
優れた熱性能と
信頼性を提供

eSMP® シリーズパッケージで 提供する製品技術

- [シリコンカーバイド \(SiC\)](#)
- [TMBS® 整流器](#)
- [ショットキー整流器](#)
- [FRED Pt® 整流器](#)
- [超高速リカバリー整流器](#)
- [アバランシェ整流器](#)
- [標準／高速リカバリー整流器](#)
- [PAR® TVSダイオード](#)
- [TransZorb® ダイオード](#)
- [ESD 保護ダイオード](#)
- [ツェナーダイオード](#)

関連リンク



[Diodes / rectifiers in
eSMP® シリーズパッケージ
のダイオード／整流器](#)

For technical questions: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com, or DiodesAsia@vishay.com